证券代码: 603068

公告编号: 2024-010

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"博通集成"、"公司")首次公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")之"标准协议无线互联产品技术升级项目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标 ETC 产品技术升级项目"、"卫星定位产品研发及产业化项目"已经达到预定可使用状态,故公司将以上募投项目予以结项,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]354 号"《关于核准博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 34,678,384.00 股,每股发行价格为人民币 18.63 元,募集资金人民币 646,058,293.92元,募集资金净额为 603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定,公司、保荐机构天风证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该

《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募投项目的基本情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及进展情况如下

单位:万元

投资项目	原募集资金拟投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度
标准协议无线互联产品技术升级项 目	10,899.97	11,067.10	101.53%
智能家居入口产品研发及产业化项 目	11,361.30	11,611.81	102.20%
国标 ETC 产品技术升级项目	8,711.08	8,967.17	102.94%
卫星定位产品研发及产业化项目	4,898.12	5,139.66	104.93%
研发中心建设项目	24,437.19	16,221.07	66.38%
合计	60,307.66	53,006.81	87.89%

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-007)。

四、募集资金使用及结项情况

本次结项的募集资金投资项目为"标准协议无线互联产品技术升级项目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标 ETC 产品技术升级项目"。截至 2023 年 12 月 31 日,公司"标准协议无线互联产品技术升级项目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标 ETC 产品技术升级项目"已实施完毕,项目已达到预定可使用状态,满足结项条件,对上述募集资金投资项目予以结项。

五、审议程序

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于募投项目结项的议案》。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会 2024年4月27日